



中華民國專利證書

新型第 M629323 號

新型名稱：覆晶封裝結構

專利權人：慧隆科技股份有限公司

新型創作人：蔡憲聰、施養明、許宏源

專利權期間：自 2022 年 7 月 11 日至 2031 年 12 月 2 日止

上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權
行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局局長

洪淑敏

中華民國 111 年 7 月 11 日

